



KC ČIP.SI
SLOVENSKI KOMPETENČNI
CENTER ZA ČIPE

NOVIČNIK

Petek, 08. maj 2026

Pozdravljeni,

tudi v tem tednu vam pošiljamo izbrane informacije in novosti s področja čipov in polprevodniških tehnologij.

Novosti KC Čip.si:

V današnjem novičniku želimo izpostaviti:

- **[Konferenca MIDEEM 2026 – vabilo k oddaji povzetkov](#)**
KC Čip.si v okviru konference MIDEEM (28.–30. september 2026, UL FE Ljubljana) soorganizira delavnico o integrirani fotoniki. Vabljeni k oddaji povzetkov s področja mikroelektronike, fotonike, komponent in materialov. Rok za oddajo: 15. maj 2026

Dogodki:

- **[Webinar: Leveraging the PIC tapeout value chain through the Luceda Photonics Design Platform](#)**
18.05.2026, 9:00-11:00 h, on-line, brezplačno
Webinar obravnava izzive v kako že v fazi načrtovanja PIC (fotonsko integrirano vezje) čipov in sistemov upoštevati procesne variacije s ciljem visokega izkoristka proizvodnje čipov.
Prijave na webinar na [povezavi](#).
- **[Webinar: From Lab to Market – How APECS and ChipNL CC enable advanced packaging in Europe](#)**
12.5.2026, 10:00-11:00 h, on-line, brezplačno
Pridružite se prvemu spletnemu seminarju serije aCCcess, kjer bo predstavljena pilotna linija [APECS](#), njene napredne storitve na področju naprednega pakiranja čipov
Predhodno je potrebna [registracija](#) na dogodek
- **[Konferenca: User2User Europe – Siemens](#)**
12.05.2026, München, Nemčija
Na konferenci bodo v ospredju tehnične predstavitve, kjer bodo predstavljene različne teme. To bo omogočalo spoznavanje novih konceptov ali poglobitev znanja na strokovni področjih katerih je možno reševati z orodji Siemens.
Za dogodek se je potrebno registrirati [tukaj](#).

Izobraževanja

- **[POEMS Learning portal je ustanovljen](#)** – vabljeni k ogledu izbraževanj
Odkrijte vse tečaje in usposabljanja naših partnerjev ter nadgradite svoje znanje na področju polprevodnikov in mikroelektronike, od osnov in načrtovanja čipov do naprednih tehnologij, kot so senzorji, fotonika in kvantne rešitve.

Ostale novice

- **[GlobalFoundries accelerates adoption of co-packaged optics for advanced AI data centers with SCALE optical module solution](#)**
GF je predstavil SCALE CPO platformo, ki združuje napredno silicijevo fotoniko in 2.5D/3D integracijo. Namenjena je pospešitvi razvoja UI infrastrukture z energijsko učinkovitejšimi in hitrejšimi medsebojnimi povezavami.
- **[2.5D + 3D = "3.5D"!](#)**
Enačba, ki ponuja odgovor, kako uravnotežiti zmogljivost, izdelavo, stroške in toplotno učinkovitost na način, ki ga s trenutno uveljavljenimi koncepti izdelave integriranih sistemov v tradicionalnem 2D pristopu ni mogoče doseči.
- **[Collaborate to Accelerate Innovation for Next-Generation Designs](#)**
TSMC in Synopsys sta združila moči ter oblikovalcem ponudila optimizirane rešitve, ki vključujejo napredna orodja, IP bloke in podporo sodobnim tehnologijam (FinFET, Nanosheet, 3DFabric™), kar omogoča razvoj vrhunskih in inovativnih čipov.

Želimo vam uspešen zaključek tedna,
vaš KC Čip.si



Slovenski kompetenčni center za čipe in polprevodniške tehnologije

KC Čip.si - glavna pisarna

Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

Tržaška cesta 25, Ljubljana

E-pošta: office@cc-chip.si

Tel.: 01 476 88 50

Spletna stran (v izdelavi): <https://cc-chip.si/>



Financira
Evropska unija



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO

Projekt CC Chip.si (št. 101217674) je sofinanciran s strani Chips Joint Undertaking in Evropske unije v okviru programa Digital Europe.

To sporočilo ste prejeli, ker ste se prijavljali na prejemanje novic KC Čip.si ali izrazili interes za obveščanje o naših dejavnostih.

Če novic ne želite več prejemati, se lahko kadarkoli odjavite.

[Odjava](#)

